

软启动 1769-L30ERMS AB罗克韦尔 编程简单易学

产品名称	软启动 1769-L30ERMS AB罗克韦尔 编程简单易学
公司名称	厦门盈亦自动化科技有限公司
价格	46.00/件
规格参数	品牌:A-B 型号:1769-L30ERMS 产地:美国
公司地址	厦门市集美区宁海三里10号1506室
联系电话	0592-6372630 18030129916

产品详情

软启动 1769-L30ERMS AB罗克韦尔 编程简单易学

1756-A10	1756-IF16	1794-IM16	1756-HSC
1756-A13	1756-IF16H	1794-IM8	1756-IA16
1756-A17	1756-IF8	1794-IR8	1756-IA16I
1756-A4	1756-IF8H	1794-IRT8	1756-IA32
1756-A7	1756-IF8I	1794-IT8	1756-IB16
1756-BA1	1756-IF6I	1794-IV16	1756-IB16D
1756-BA2	1756-IF6CIS	1794-IV32	1756-IB16I
1756-BATA	1756-IT6I	1794-OA16	1756-IB32
1756-CN2	1756-IR6I	1756-M03SE	1756-BATA
1756-CN2R	1756-IR12	1756-M08SE	1756-CNB
1756-CNB	1756-IRT8I	1756-M16SE	1756-IC16
1756-CNBR	1756-IT6I2	1756-N2	1756-IB16

1756-DHRIO	1756-IM16	1756-OA16	1756-IB32
1756-DNB	1756-L61	1756-OA16I	1756-IF16
1756-EN2T	1756-L62	1756-OB16D	1756-IR61
1756-EN2TR	1756-L63	1756-OB16E	1734-ACNR
1756-EN3TR	1756-L64	1756-OB16I	1734-ADN
1756-ENBT	1756-L65	1756-OB32	1734-AENT
1756-ENET	1756-L71	1756-OF4	1734-AENTR
1756-EWEB	1756-L71S	1756-OF8	1734-APB
1756-TBS6H	1756-PA75R	1756-OF8I	1746-IA16
1756-TBSH	1756-PB72	1756-OW16I	1746-IB16
1757-SRM	1756-PB75	1756-PA72	1746-IB32
1746-N2	1756-RM	1756-PA75	1746-IM16
1746-NI16I	1756-IB16	1794-OA8	1746-IO12DC
1746-NI4	1746-IV32	1794-OA8I	1746-ITB16

软启动 1769-L30ERMS AB罗克韦尔 编程简单易学

近日，一年一度的TCL技术创新大会在深圳举行。会上，TCL研发领域荣誉“技术创新奖”揭晓，格创东智凭借“天津硅晶圆外观 AOI 检查机”荣获2022-2023年度“TCL技术创新一等奖”。这也是继2022年后，格创东智再次荣膺此项殊荣。

近年来格创东智大力投入半导体AOI领域的技术研发，在光学、图像处理和人工智能算法等技术领域不断取得突破。“天津硅晶圆外观 AOI 检查机”由格创东智牵头联合TCL工研院、天津共同研发，实现了软件、硬件、算法、制程know how的三方协同，突破了自动高清微米级成像、通用型异常定位（HGAD）、大模型本地离线部署、智能自动化检测和实时监控和预警5大关键技术，其独创的光学系统设计、引领行业的缺陷检测、兼容多种工艺产品、超高设备产率、量身定制监控系统等创新，做到国内首创。

硅晶圆是半导体制造中的重要材料，针对其表面的质量问题进行检测和评估至关重要。在制备过程中，硅晶圆外观容易产生药液残留、蹭伤、裂纹等缺陷，对下游芯片的品质造成负面影响。目前，硅晶圆的外观检测主要依靠经验丰富的操作人员进行目测来检查是否存在缺陷，这种方法存在着人为主观性强、效率低下、易漏检等问题，对工业生产造成较大困扰。借助先进的AOI技术来实现对硅晶圆外观缺陷的高精度、高效率检测成为了行业实现降本增效、提升产品品质的必要手段。

目前，通过“天津硅晶圆外观 AOI 检查机”孵化的相关技术也已推广应用于半导体、SIC、光伏等制造领域，在提升产品质量的同时，还能进一步降低成本和提升生产效率。未来，格创东智将进一步突破AOI视觉检测关键技术，大力创新，为相关产业发展提供更好的智能化服务。

软启动 1769-L30ERMS AB罗克韦尔 编程简单易学